

PRESSEMITTEILUNG

AEMtec auf der SMT HYBRID PACKAGING 2014

- Von miniaturisierten Einzelkomponenten über die Aufbautechnik bis zum integrierten System – Halle 9 / Stand 537

Berlin, 22.04.2014, AEMtec stellt auf der SMT Hybrid Packaging, Europas größter Spezialmesse für Systemintegration in der Mikroelektronik vom 06. bis 08. Mai 2014, Halle 9 / Stand 537 aus.

Die zur exceet Group gehörende AEMtec GmbH ist, ein führendes Berliner Technologieunternehmen für kundenspezifische Mikroelektronikfertigung. Wir begleiten Projekte führender national und international tätiger Unternehmen aus den verschiedensten Branchen wie Medizintechnik, Daten- und Telekommunikation, Industrie & Automatisierung, Halbleiter, Sicherheits- und Automobiltechnik vom anfänglichen Konzept bis zum fertigen Produkt. Langjährige Expertise in der Produkt- & Prozessentwicklung in Verbindung mit High-end Technologien ermöglichen eine schnellstmögliche Umsetzung innovativer Produktideen.

Komplexe (Opto)Elektronik klein und funktional

Die stete Miniaturisierung der Elektronik wird zunehmend aufwendiger und komplexer. Immer mehr sind Präzision und Qualität gefragt. CoB (Chip on Board), Flip-Chip, SiP (System in Packages) und andere Verfahren sind heute vermehrt gefordert und verlangen eine extrem dichte Bestückung auf kleinstem Raum. Anspruchsvolle Produktideen werden mit eigenen Ressourcen umgesetzt und durch die Zusammenarbeit mit namhaften Forschungseinrichtungen unterstützt. Dadurch gestaltet AEMtec, Forschung und Entwicklung aktiv mit und steigert stetig die eigene Engineering-Kompetenz. Darüber hinaus werden innovative Produkttechnologien vorangebracht und kontinuierlich neue Produkte entwickelt.

Über AEMtec, ein Unternehmen der exceet Gruppe

AEMtec, mit Firmensitz und Fertigungsstätte am renommierten Wissenschafts und Technologiestandort Berlin Adlershof, bietet hoch qualitative, miniaturisierte Technologien für kundenspezifische komplexe (opto-)elektronische Anwendungen. Das Unternehmen verfügt über ein breites Spektrum an High-end Chip-level-Technologien, wie Chip on Board, Flip Chip, 3D-Integration und Opto-Packaging. Umfangreiche Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Machbarkeitsstudien zur Aufbau- und Verbindungstechnik, Design und Layout sowie Testequipment-Erstellung bis hin zur Überführung in die Serienproduktion runden das Dienstleistungsspektrum ab.

Über die exceet Group

exceet ist ein internationaler Technologiekonzern, der sich auf die Entwicklung und Fertigung intelligenter, komplexer und sicherer Elektronik spezialisiert hat.

Kontakt

Fabian Rau
Vice President Marketing
exceet Group SE
E-Mail: f.rau@exceet.ch
Phone: +49 172 3653167